



PROGETTO RANDIT - Approfondimenti

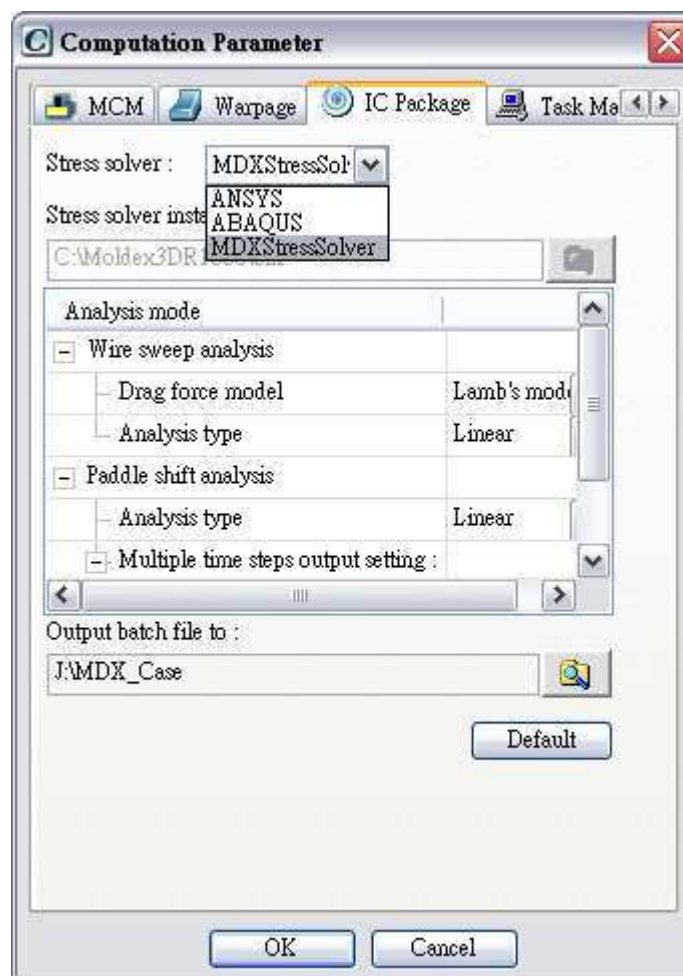


Moldex3D eDesign Sottosistema di analisi iniezione plastica Affidabilità del risolutore strutturale interno

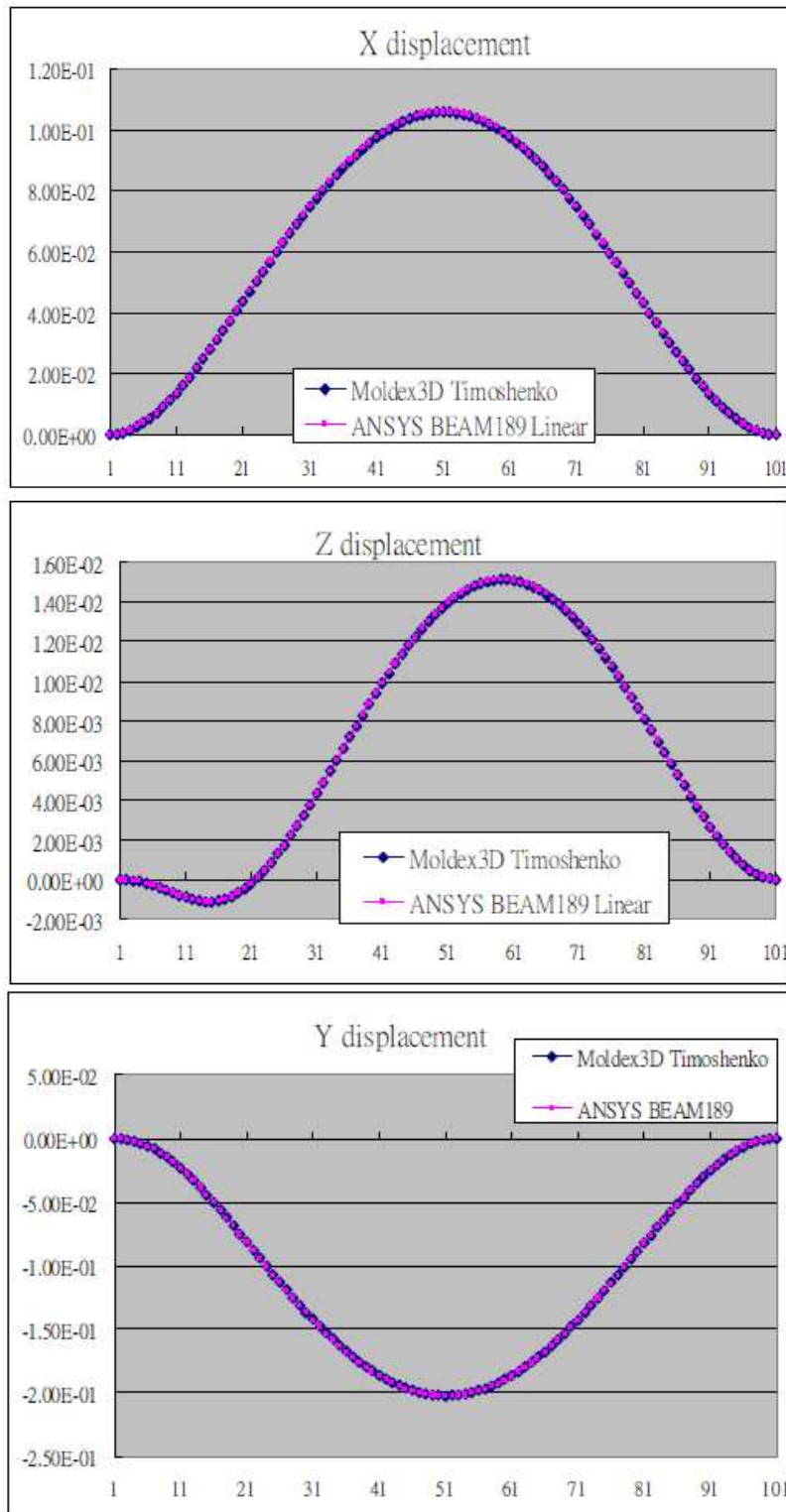
Dalmine , 15 gennaio 2010

Spesso le problematiche legate allo studio dell'iniezione plastica si combinano anche con le necessità di effettuare una verifica dello stress a cui il materiale viene sottoposto.

A tal proposito, i sistemi , ed. come Moldflow, delegano ad altro sistema specifico questo tipo di analisi. Moldex3D eDesign. MDX Stress Solver contenuto nel pacchetto IC Interface Connector, con la versione R.10.0 in arrivo a breve, fornisce un risolutore interno (Stress Solver) di assoluto livello ed affidabilità in termini di consistenza del risultato ottenuto.



Lo possiamo verificare di seguito confrontando i risultati ottenuti con il risolutore interno di eDesign (Stress Solver) e Ansys.

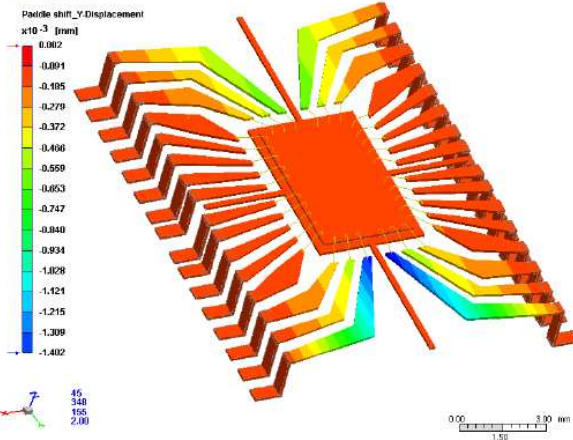


Come si può vedere nelle figure la deviazione dai valori prodotti dal risolutore di Ansys e quello interno di eDesign è pressoché nulla ed inesistente, ed i valori di displacement indicati sotto sono perfettamente identici (il riferimento è sempre ad Ansys).



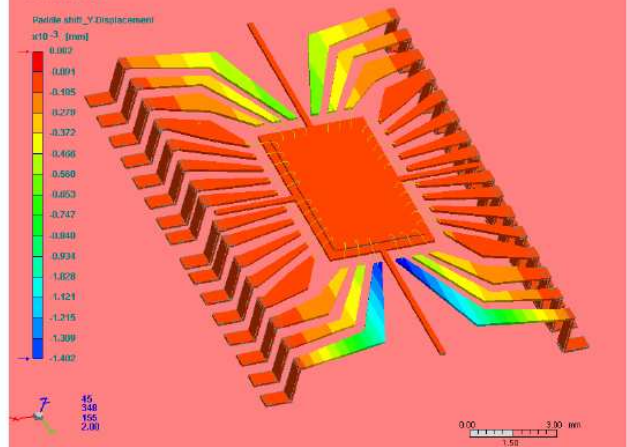
MDX Stress Solver

Moldex3D



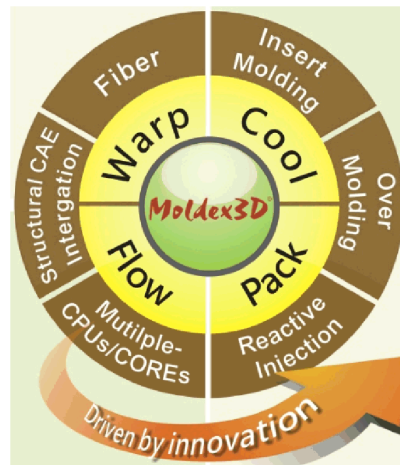
ANSYS: SOLID185, Default Setting

Moldex3D



Con la release 10.0 si potrà effettuare le verifiche necessarie senza dover passare da un sistema all'altro, ma rimanendo sempre in eDesign.

Tutto questo dimostra l'estrema capacità innovativa di Moldex3D e la velocità nell'apportare nuove funzionalità richieste dai clienti.



Giorgio Nava - Randit